

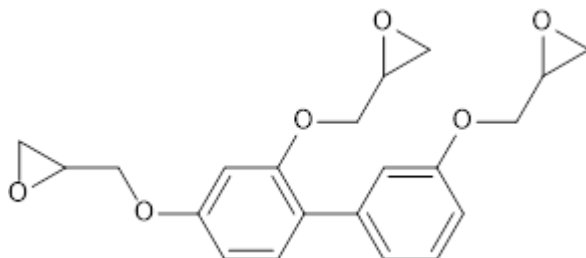
2025 年 8 月 6 日  
日本材料技研株式会社

## ビフェニル骨格含有エポキシ化合物の製造方法に関する 三井化学とのライセンス契約の締結について

日本材料技研株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 浦田 興優、以下「当社」）は、このたび、三井化学株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 橋本 修、以下「三井化学」）と、ビフェニル骨格含有エポキシ化合物の製造方法に関するライセンス契約（以下「本契約」）を締結しました。

本契約の対象となる技術は、三井化学が開発した残留塩素量が低減されたビフェニル骨格を含有する多官能エポキシ化合物（以下「本化合物」）の製造方法（以下「本製法」）です。本化合物は剛直なビフェニル骨格を有しており、樹脂に配合することで高耐熱化、高熱伝導率化、低熱膨張率化（低 CTE 化）を図れます。また、低融点かつ低粘度で溶剤溶解性が高いといった特徴を有し、樹脂組成物の低粘度化やハンドリング性の向上が可能です。さらに、特定の構造では室温付近で液体となるため、液状組成物、塗料、コーティング材等の様々な用途への展開が期待されます。当社は、本契約によって取得した独占的通常実施権を活用し、樹脂材料メーカー等に本化合物を供給することで、早期の事業化を図ってまいります。

＜本化合物の構造の一例＞



当社では、これまでに脂環式エポキシ DCPD-DE、三官能性ベンゾオキサジン BTBz、ダブルデッカーシルセスキオキサン脂環式酸二無水物、負熱膨張材料 BNFO、樹脂微粒子などの樹脂組成物に配合することで、高耐熱化、低熱膨張率化が可能な材料の工業化に取り組んでいます。エレクトロニクス製品の高性能化・小型化などに伴い、低熱膨張、高耐熱などの熱マネジメント、及び、材料の低粘度化に関するニーズが急速に拡大・多様化しています。当社では、今後もこれらのニーズに対応するため、革新的なエレクトロニクス関連材料の製品化に積極的に取り組んでまいります。

当社は、国内企業や大学・研究機関等で開発された革新的技術について、ライセンスアウトやカープアウトを通じた事業化に取り組んでまいりました。今後も未活用の革新的材料技術の商業化を進めることで、日本の素材産業におけるイノベーション創出に貢献してまいります。

以 上